

# 海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 2023年度担保额度预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2023年度担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、担保情况概述

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于2023年为子公司提供预计合计不超过人民币30,000.00万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述对外担保额度预计的有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会审议之日止。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	东芯半导体(香港)有限公司	30,000.00
合计		30,000.00

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据公司章程及《对外担保管理办法》的相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保事项的授权有效期自公司2023年年度股东

大会审议通过之日起12个月内。

## 二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：东芯半导体(香港)有限公司
- 2、成立日期： 2014年11月26日
- 3、注册地址： 香港金钟夏悃道16号远东金融中心43楼08室
- 4、注册资本： 1,035.00万港币
- 5、经营范围： 半导体芯片的销售
- 6、股权结构及与本公司关系：东芯半导体(香港)有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
- 7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年度
资产总额	40,683.45
负债总额	46,481.51
净资产	-5,798.06
营业收入	38,323.48
净利润	-7,769.11

- 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
- 9、东芯半导体(香港)有限公司不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

担保对象包括如下全资子公司：

东芯半导体（香港）有限公司，公司持股比例为100%。

#### 四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

（一）公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，被担保对象为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。综上，董事会同意《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

（二）公司独立董事认为：公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司及子公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，公司独立董事一致同意《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司2023年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张坤

张坤

陈城

陈城



海通证券股份有限公司

2023年4月14日